

STREF-MKI128V6 スマートMEMSマルチセンサ・モジュール



柔軟なプロトタイプ作成が可能なスマート・マルチセンサ・モジュールにより
クリエイティブなアイデアの迅速な開発・設計をサポート

STREF-MKI128V6 MEMSセンサ・モジュールの強化された組込みセンサ・トポロジにより、様々なアプリケーションのスマートでクリエイティブなプロトタイプを開発する際に、時間と労力の節約に貢献します。

この小型ボードには、OIS/EISおよびAR/VRシステムを備えたスマートフォンに最適な3軸加速度センサと3軸ジャイロ・センサ内蔵のiNEMO慣性モジュール(LSM6DSM)、地磁気センサ(LIS2MDL)、防塵性の高いフルモールド大気圧センサ(LPS22HB)、および相対湿度 & 温度センサ(HTS221)が集積されています。

特徴

モーションMEMSセンサ

- 選択可能な $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16\text{g}$ のフルスケール加速度範囲を備えた3軸加速度センサ
- 14ピンLGAパッケージ($2.5 \times 3 \times 0.83\text{mm}$)に封止され、選択可能な $\pm 125/\pm 245/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000\text{dps}$ のフルスケール角速度範囲を備えた3軸ジャイロ・センサ
- 12ピンLGAパッケージ($2 \times 2 \times 0.7\text{mm}$)に封止され、選択可能な $\pm 4/\pm 8/\pm 12/\pm 16\text{gauss}$ のフルスケール磁場範囲を備えた3軸地磁気センサ

環境センサ

- 高精度大気圧センサ
- ピエゾ抵抗式圧力センサ

- 絶対大気圧範囲: 260 ~ 1260mbar
- 低消費電力
- 温湿度センサ
 - 相対湿度範囲: 0 ~ 100%
 - 温度範囲: -40 ~ 120°C
 - 16bit ADコンバータ測定

アプリケーション

- OIS/EISおよびAR/VRシステムを備えたタブレットと携帯電話
- ゲーム機 & VR入力装置
- ウェルネス & ウエアラブル機器
- ドローン & ロボット
- 産業オートメーション / ファクトリ・オートメーション・システムを含むIoT機器

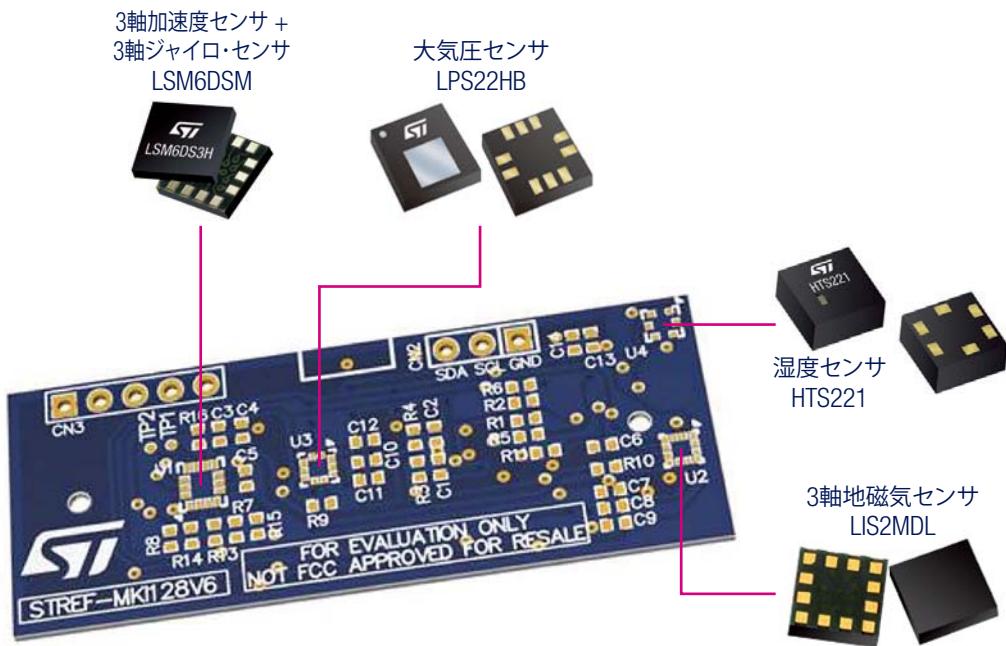
STREF-MKI128V6 MEMSセンサ・モジュールは、様々なモーションMEMSセンサおよび環境センサを集積しています。迅速なシステム・プロトタイプの作成と開発を実現する堅牢で組立てやすいビルディング・ブロックです。

このセンサ・モジュールとそのコンパニオン・ソフトウェアによって、スマートフォンやタブレットのアプリケーション、ゲーム機、拡張現実(AR)、屋内ナビゲーション、およびロケーション・ベース・サービスなどに対応する完全なプラットフォームを開発を可能にする便利でユニークなセンサ・サブシステム・ソリューションを提供します。

固有の開発プラットフォームに最適なコンパニオン・センサ・モジュールで、ソフトウェアとハードウェアの両方の開発ツールを提供し、迅速な評価とシームレスな製品開発を可能にします。

組込みセンサ

- **LSM6DSM** : 3軸加速度センサ + 3軸ジャイロ・センサ
- **LIS2MDL** : 3軸地磁気センサ
- **LPS22HB** : 大気圧センサ
- **HTS221** : 温湿度センサ



© STMicroelectronics - August 2018 - Printed in Japan - All rights reserved.
STMicroelectronicsのロゴマークは、STMicroelectronics Groupの登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者に帰属します。
STマイクロエレクトロニクス株式会社 ■ 東京 TEL 03-5783-8200 ■ 大阪 TEL 06-6397-4130 ■ 名古屋 TEL 052-259-2725

